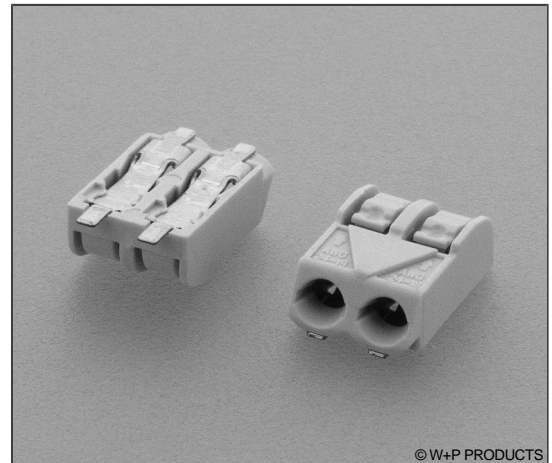


# 5253

## SMT LED-Mini-Anschlussklemmen - anreihbar SMT LED Mini Terminal Blocks - horizontally stackable

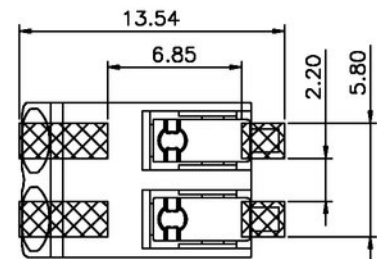
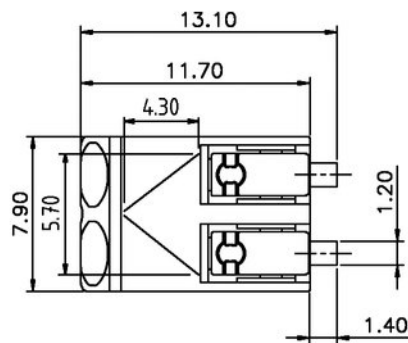
### Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Kupferlegierung <i>Copper alloy</i>
Aderquerschnitt <i>Applicable wire Gauge</i>	Einzeldraht: 0,2-0,75mm <sup>2</sup> Litze: AWG24-AWG18 <i>Solid wire: 0.2-0.75mm<sup>2</sup></i> <i>Stranded wire: AWG24-AWG18</i>
Lötbarkeit <i>Solderability</i>	IEC 60512-12A <i>IEC 60512-12A</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20mΩ <i>&lt; 20mΩ</i>
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000MΩ <i>&gt; 1000MΩ</i>
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	320V <sub>AC</sub> <i>320V<sub>AC</sub></i>
Nennstrom <i>Current Rating</i>	9A max. <i>9A max.</i>
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-35°C ... +105°C <i>-35°C ... +105°C</i>
Verarbeitung <i>Processing</i>	260°C max. für 3-5s <i>260°C max. for 3-5s</i>

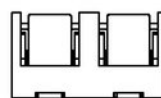
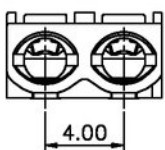


© W+P PRODUCTS

5253



RECOMMEND PCB LAYOUT  
TOLERANCE=±0.05mm



Series	Contacts*	Version	Colour	Plating	Package
<b>5253</b>	<b>02</b> 01-03	<b>2</b> 2 Buchsenkontakt Female	<b>60</b> 60 Grau Grey	<b>50</b> 50 Verzinkt Tin plated	<b>TR</b> TR Tape & Reel

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -  
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** -  
please replace by your specifications.

## Informationen zum kurzen Reflow-Lötverfahren Fast Profile Reflow Soldering Information

### Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten Reflow Soldering Recommendation for shorter peak times

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150°C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	120-150s
Temperatur Lötbereich $T_L$	230°C
Verweildauer oberhalb $T_L$	60s max.
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 1,5°C / s
Höchsttemperatur $T_P$	260°C max.
Dauer Höchsttemperatur	5-10s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	3°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur $T_P$	Max. 4,5min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150°C
Maximum Temperatur $T_{Smax}$	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	120-150s
Soldering Range Temperature $T_L$	230°C
Duration above $T_L$	60s max.
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 1.5°C / s
Peak Temperature $T_P$	260°C max.
Duration Peak Temperature	5-10s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	3°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	Max. 4.5min

